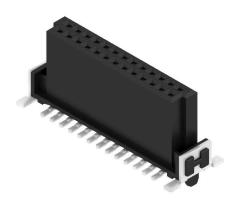


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild













1

OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder
Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten
Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die
Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der
Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in
der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Boardto-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und
bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale
Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontakt-Koplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen z. B.
 Schrägstellung oder Versatz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD- Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 180°, Tape
BestNr.	<u>2747370000</u>
Art	FFH9 S1/26V F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000952
VPE	280 ST
Produkt-Kennzahlen	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
Verpackung	Tape





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
Zulassungen			
	C Wus		
BOLLO			
ROHS UL File Number Search	Konform		
Zertifikat-Nr. (cURus)	UL Webseite E92202		
Lei tilikat-ivi. (COnus)	Lazzoz		
Abmessungen und Gewicht	te		
Tiefe	7.8 mm	Tiefe (inch)	0.3071 inch
Höhe	9.9 mm	Höhe (inch)	0.3898 inch
Breite	21.59 mm	Breite (inch)	0.85 inch
Nettogewicht	2.88 g		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	9	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gev		
Systemkennwerte			
Übertragungsrate	3,125 Gbit/s	Produktfamilie	OMNIMATE Signal -
A 11	Di di		Board-to-Board
Anschlussart Raster in mm (P)	Platinenanschluss 1.27 mm	Montage auf der Leiterplatte Raster in Zoll (P)	SMD-Lötanschluss 0.050 "
Abgangswinkel	1.27 mm	Polzahl	26
Anzahl Lötstifte pro Pol	1	Koplanarität	0.1 mm
Anzahl Reihen	<u>'</u> 	Polreihenzahl	2
Schutzart	IP20	Durchgangswiderstand	 <25 mΩ
Steckzyklen	500	Steckkraft/Pol, max.	0.6 N
Ziehkraft/Pol, max.	0.6 N		
Werkstoffdaten			
solierstoff	LCP	Farbe	schwarz
solierstoff Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	Illa
lsolierstoff Farbtabelle (ähnlich) Isolationswiderstand	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL)	IIIa 1
lsolierstoff Farbtabelle (ähnlich) Isolationswiderstand Brennbarkeitsklasse nach UL 94	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω V-0	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL) Kontaktbasismaterial	Illa 1 Kupferlegierung
Isolierstoff Farbtabelle (ähnlich) Isolationswiderstand Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Kontaktmaterial	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω V-0 Cu-leg	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL) Kontaktbasismaterial Kontaktoberfläche	Illa 1 Kupferlegierung Gold über Nickel
Isolierstoff Farbtabelle (ähnlich) Isolationswiderstand Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Kontaktmaterial	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω V-0	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL) Kontaktbasismaterial	Illa 1 Kupferlegierung
solierstoff Farbtabelle (ähnlich) solationswiderstand Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Kontaktmaterial Schichtaufbau - Steckkontakt	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω V-0 Cu-leg ≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au 70 °C	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL) Kontaktbasismaterial Kontaktoberfläche	Illa 1 Kupferlegierung Gold über Nickel
solierstoff Farbtabelle (ähnlich) solationswiderstand Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Kontaktmaterial Schichtaufbau - Steckkontakt Lagertemperatur, max.	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω V-0 Cu-leg ≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL) Kontaktbasismaterial Kontaktoberfläche Lagertemperatur, min.	Illa 1 Kupferlegierung Gold über Nickel -40°C
Isolierstoff Farbtabelle (ähnlich) Isolationswiderstand Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Kontaktmaterial Schichtaufbau - Steckkontakt Lagertemperatur, max. Betriebstemperatur, max.	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω V-0 Cu-leg ≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au 70 °C 125 °C	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL) Kontaktbasismaterial Kontaktoberfläche Lagertemperatur, min.	Illa 1 Kupferlegierung Gold über Nickel -40°C
Werkstoffdaten Isolierstoff Farbtabelle (ähnlich) Isolationswiderstand Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Kontaktmaterial Schichtaufbau - Steckkontakt Lagertemperatur, max. Betriebstemperatur, max. Bemessungsdaten nach IEC	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω V-0 Cu-leg ≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au 70 °C 125 °C	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL) Kontaktbasismaterial Kontaktoberfläche Lagertemperatur, min. Betriebstemperatur, min.	Illa 1 Kupferlegierung Gold über Nickel -40 °C -55 °C
Isolierstoff Farbtabelle (ähnlich) Isolationswiderstand Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Kontaktmaterial Schichtaufbau - Steckkontakt Lagertemperatur, max. Betriebstemperatur, max.	RAL 9011 ≥ 10 ¹⁰ Ω V-0 Cu-leg ≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au 70 °C 125 °C	Isolierstoffgruppe Moisture Level (MSL) Kontaktbasismaterial Kontaktoberfläche Lagertemperatur, min.	Illa 1 Kupferlegierung Gold über Nickel -40°C

Erstellungs-Datum 10.11.2025 06:51:10 MEZ

Hinweis zu den Zulassungswerten

Katalogstand / Zeichnungen 2

(veraltet)

Bemessungsspannung (UL 1977)

150 V

Angaben sind

Maximalwerte, Details

siehe Zulassungs-Zertifikat.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Verpackungen			
Mana a da un m	T	\/DE #	250.00
Verpackung	Tape	VPE Länge	359.00 mm
VPE Breite	346.00 mm	VPE Höhe	149.00 mm
Wichtiger Hinweis			
IPC-Konformität	entwickelt, gefertigt u	ukte werden nach international anei ind ausgeliefert und entsprechen de	en zugesicherten Eigenschaften im
		en dekorative Eigenschaften in Anle orüche an die Produkte können auf A	hnung der IPC-A-610 "Class2". Darüb Anfrage bewertet werden.
Hinweise			
Hinweise Klassifikationen			
Klassifikationen			
Klassifikationen	hinaus gehende Ansp	orüche an die Produkte können auf A	Anfrage bewertet werden.
	hinaus gehende Ansp	orüche an die Produkte können auf A	Anfrage bewertet werden. EC002637
Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	hinaus gehende Ansp EC002637 EC002637	erüche an die Produkte können auf A ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002637
Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002637 EC002637 EC002637	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002637 EC002637 27-44-04-02
Klassifikationen ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002637 EC002637 EC002637 27-44-04-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002637 EC002637 27-44-04-02 27-44-04-02



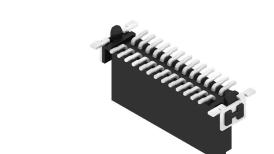
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

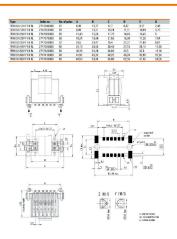
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktbild

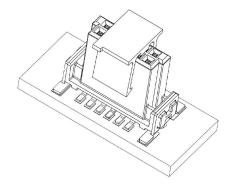


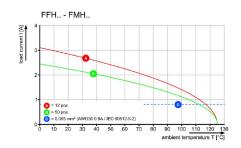
Maßbild



Detailzeichnung

Deratingkurve





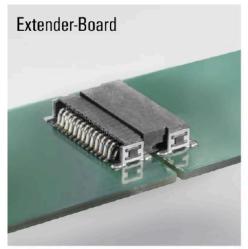


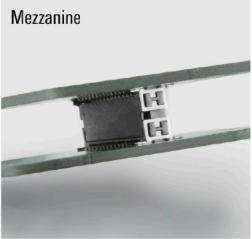
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

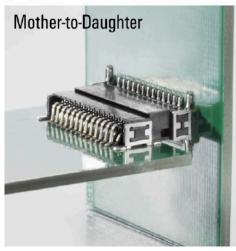
Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

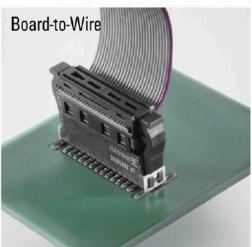
www.weidmueller.com

Zeichnungen













Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke

FMH - Stiftleiste, Leiterplattenanschluss



OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontakt-Koplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

Allgemeine Bestelldaten

Art	FMH S1/26H F1 B RL	Ausfuehrung
BestNr.	2747190000	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
GTIN (EAN)	4064675000976	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 90°, Tape
VPE	560 ST	

Erstellungs-Datum 10.11.2025 06:51:10 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke

FMH1 - Stiftleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 1,75 mm)



OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontakt-Koplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

Allgemeine Bestelldaten

Art	FMH1 S1/26V F1 B RL	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2747010000</u>	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
GTIN (EAN)	4064675001225	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 180°, Tape
VPE	280 ST	

·



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke

FMH3 - Stiftleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 3,25 mm)



OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontakt-Koplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

Allgemeine Bestelldaten

IH3 S1/26V F1 B RL	Ausfuehrung
· ·	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 26, 180°, Tape
0 ST	
6	7100000 4675001218

Erstellungs-Datum 10.11.2025 06:51:10 MEZ